

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-40

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	国海证券、平安基金、西部利得基金、创金合信基金、鹏华基金、惠通基金、景顺长城基金、华泰资产、易方达基金
时间	2024年7月10日
地点	国海证券策略会举办地、网络及电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； 证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2024年上半年业绩预增情况。</p> <p>2024年上半年，公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于AI的加速演进及应用深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。</p> <p>公司预计2024年上半年实现归母净利润9.1亿元-10亿元，预计同比增长92.01%-111.00%；预计实现扣非净利润8.2亿元-9.1亿元，预计同比增长92.64%-113.78%。相关业绩预告数据为公司财务部初步核算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。</p> <p>Q2、请介绍公司目前PCB业务产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在PCB业务方面从事高中端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p>

Q3、请介绍公司 PCB 业务通信领域近期经营拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年一季度以来，无线侧通信基站相关产品需求较去年第四季度未出现明显改善，有线侧交换机、光模块等产品需求有所增长。

Q4、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。

伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求受到上述趋势的影响。

Q5、请介绍公司 PCB 业务汽车电子领域近期经营拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内 Tier1 客户。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2024 年一季度以来，公司 PCB 业务在汽车电子领域继续把握新能源和 ADAS 方向的机会，聚焦国内外目标客户的开发突破，推进定点项目需求的释放。

Q6、请介绍公司 PCB 各工厂是否区分不同下游领域安排生产。

公司在深圳、无锡、南通拥有多个 PCB 工厂。除部分专业工厂外，公司主要根据不同 PCB 产品的工艺要求特征来安排生产，产线本身对工艺相似的不同下游领域产品具有一定兼容性。

Q7、请介绍公司封装基板业务近期经营拓展情况。

2024 年一季度以来，公司封装基板业务 BT 类产品需求整体延续去年第四季度态势，部分细分领域产品结构随下游需求波动有所调整；FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

Q8、请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。

公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP 封装基板产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。

Q9、请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较一季度变化情况。

公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。

Q10、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

Q11、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

	注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2024年7月10日